

13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-2)	-3)	+	-2)	-3)	-2)	-3)	-3)	+
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	-2)	+4)	+	-2)	+4)	-2)	+4)	+4)	+
15	Bauweisen 13 unter Pflaster	-2)	+	+	-2)	+	-2)	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E	-2)	+	+	-2)	+	-2)	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-2)	+	+	-2)	+	-2)	+	+	+

1) Zulässig, wenn Chrom, ges. $\leq 110 \mu\text{g/l}$ und PAK15 $\leq 2,3 \mu\text{g/l}$.

2) Zulässig, wenn Chrom, ges. $\leq 15 \mu\text{g/l}$, Kupfer $\leq 30 \mu\text{g/l}$, Vanadium $\leq 30 \mu\text{g/l}$ und PAK15 $\leq 0,3 \mu\text{g/l}$.

3) Zulässig, wenn Vanadium $\leq 55 \mu\text{g/l}$ und PAK15 $\leq 2,7 \mu\text{g/l}$.

4) Zulässig, wenn Vanadium $\leq 90 \mu\text{g/l}$.